

Proiectarea pentru fabricație –
Design for manufacturing

9.7. Panelarea și realizarea pachetului de documentație PCB

Documentația de panelare trebuie să fie un desen (fig.9.7.1) în format .dxf care să cuprindă:

- dispunerea circuitelor în panel, inclusiv numerotarea lor;
- referința (originea) fiecărui circuit individual;
- referința (originea) panelului;
- unghiul de rotație a circuitului în ansamblul panelului;
- cotele de gabarit ale panelului (inclusiv marginile tehnologice) și a circuitului de bază;
- dispunerea reperelor locale (de circuit);
- dispunerea reperelor fiduciale globale (de panel).

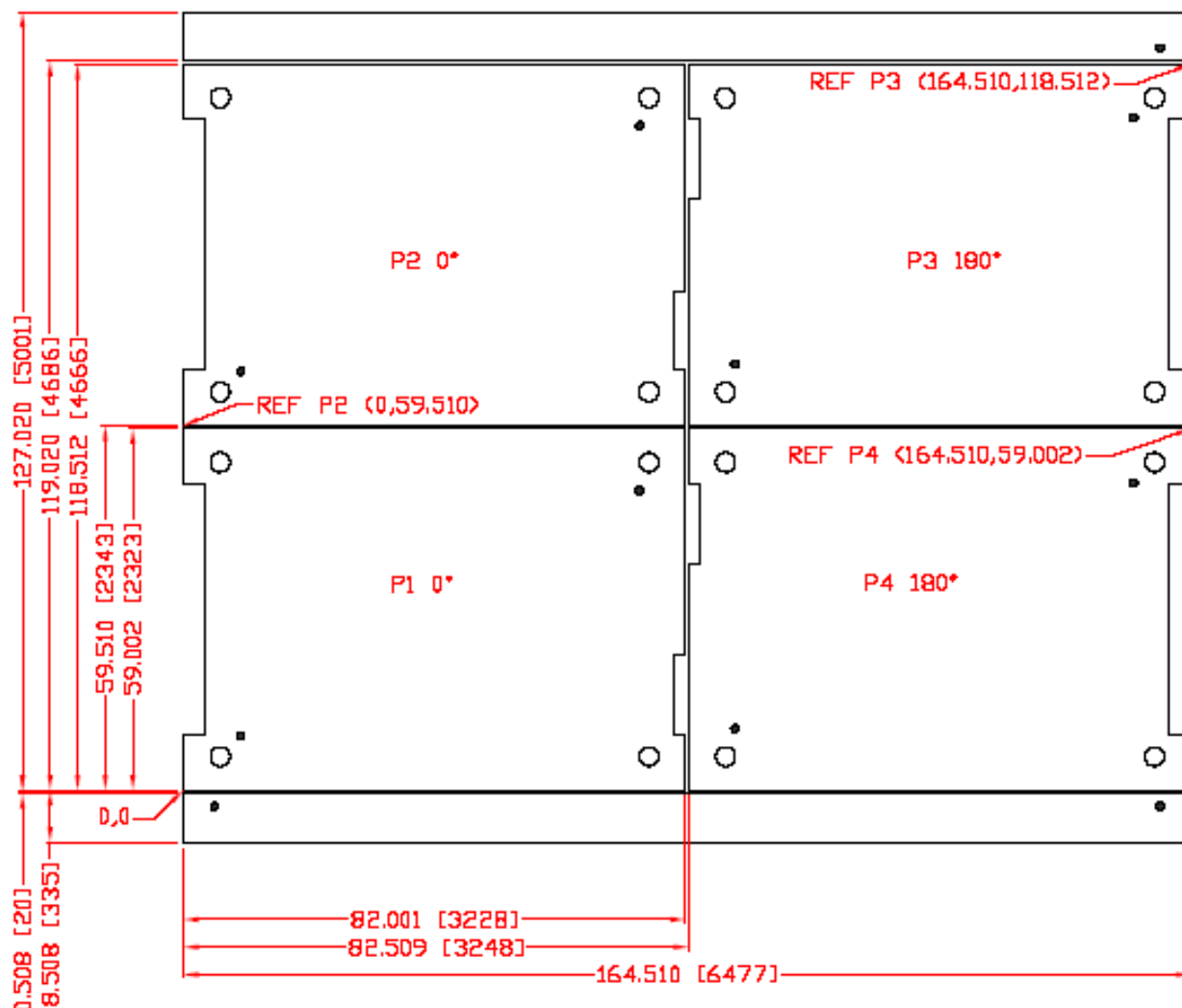


Fig.9.7.1. Desenul de panelare

Pachetul de documentație pentru realizarea cablajului panelat trebuie să conțină fișierele Gerber pentru următoarele nivele:

1. Assembly top panel (_P.AST)
2. Assembly bottom panel (_P.ASB)
3. Solder mask top panel (_P.SMT)
4. Solder mask bottom panel (_P.SMB)
5. Solder paste top panel (_P.SPT)
6. Solder paste bottom panel (_P.SPB)

ELAN

**Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Inițiativă în Industria Electronică
Investește în oameni !**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Proiectarea pentru fabricatie – Design for manufacturing

7. *Fiducials top*

8. *Fiducials bot*

Reperetele fiduciale pot fi date si ca un fisier text care sa cuprinda coordonatele centrelor reperelor.